

# 倒装芯片助焊剂NC-699

## 简介

**倒装芯片助焊剂NC-699**是一款无卤免洗的倒装芯片浸蘸型助焊剂，其残留物良性、透明。残留物的减少可帮助优化底部填充胶，并减少底部填充胶固化时可能产生的排气现象。

## 特点

- 专门为铜柱倒装芯片浸蘸型应用设计
- 适合无铅合金
- 为小于1mm<sup>2</sup>的MEMS器件设计
- 无气泡真空包装
- 残留极低
- 无卤、免洗

## 属性

属性	数值	测试方法
助焊剂类型	RELO	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.3.32 & 2.3.33)
颜色	淡黄色	肉眼观察
典型黏度	1475cps	Brookfield DV-I. 40CPE Spindle @10rpm (3分钟后)
典型酸值	39mg KOH/g	滴定法
表面绝缘电阻 SIR (ohms)	合格	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.3.3 IPC-B-24)
回流后残留物比重 (典型值)	<5%	TGA数据
使用寿命	≥ 8 小时	客户反馈 (浸蘸)

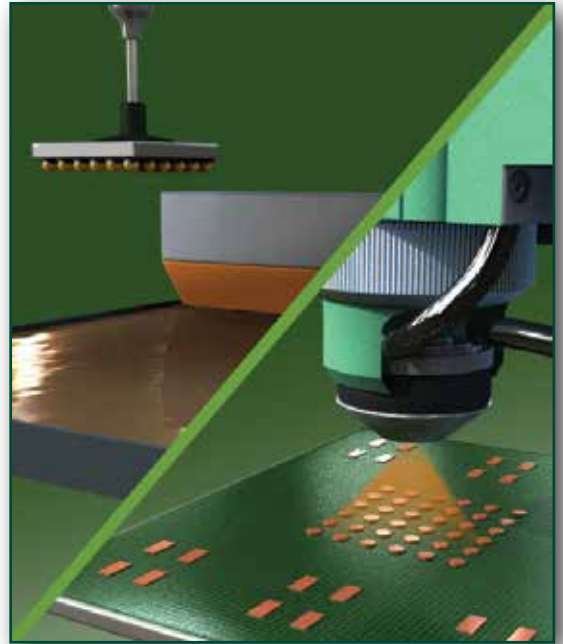
所有信息仅供参考。

## 应用

**倒装芯片助焊剂NC-699**在环氧树脂型底部填充胶（尤其是环氧胺和环氧酸等材料）上的黏性很强。**倒装芯片助焊剂NC-699**也适用于很多环氧酞型的材料。

## 清洁

**倒装芯片助焊剂NC-699**专门为免洗应用设计。如果需要，助焊剂可以用市售助焊剂清洗剂去除。适配清洗剂的选择请咨询钢泰公司的工程师。



## 技术服务

钢泰公司拥有经验丰富的国际工程师可为我们的客户提供深度技术协助。技术支持工程师深谙电子和半导体封装领域中材料科学应用的各个方面，其快速应答和随时提供现场技术支持的高品质服务设立了行业标杆。钢泰公司的技术支持工程师竭诚为您服务，将第一时间回应所有技术咨询。

## 安全说明书

如欲获取本产品的安全说明书，敬请访问：  
<http://www.indium.com/sds>。

翻页 →

# 倒装芯片助焊剂NC-699

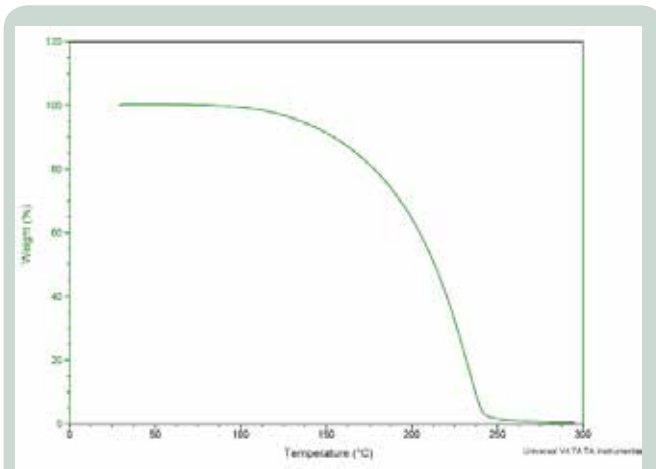
## 包装

倒装芯片助焊剂NC-699的包装规格从100克到3.2千克（1加仑）。其它包装也可应求提供。

## 储存

倒装芯片助焊剂NC-699应被储存在0°C-30°C的环境中以保证最长的保质期。倒装芯片助焊剂NC-699使用前应升温到工作环境温度。

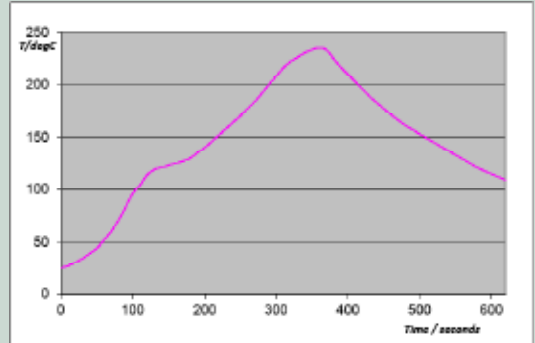
## 热重分析 (TGA)



热重分析 (TGA) 采取的升温速度为10°C/分钟。

## 回流

### 推荐的温度曲线



倒装芯片助焊剂NC-699应使用氧气含量低于100ppm的氮气气氛进行回流。尽管取得最佳结果仍需惰性气氛，某些应用可采用空气气氛。倒装芯片助焊剂NC-699可在多种表面上使用，包括浸银、铜和AuNi。这些表面可用无铅合金进行焊接，然而当温度超过240°C以后需要使用氮气气氛。

本产品说明书仅供参考，并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明，钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

立即联络: [china@indium.com](mailto:china@indium.com)

更多详情: [www.indium.com](http://www.indium.com)

中国 +86 (0) 512 628 34900 • 亚洲 +65 6268 8678 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900



©2017 Indium Corporation